

平成 23 年 5 月 23 日

各位

会社名	富士機械製造株式会社
代表者名	代表取締役社長 曾我 信之
問合せ先	ハテック事業本部営業企画部部长 相樂 美次
電話	(0566) 81-8263

### 業務提携と新製品に関するお知らせ

富士機械製造株式会社は、高度化する表面実装技術に対応するために、韓国コーヨンテクノロジー社（コーヨン社）の協力により、印刷後の SPI 機能\*をモジュール型高速多機能装着機「NXT II（ネクスト・ツー）」上で提供するための検査ヘッドを開発しました。

コーヨン社は韓国を代表する各種検査装置のトップメーカーで、世界中の大手ユーザーを中心に多数の導入実績があります。マウンターのトップメーカーである当社とはんだ検査装置のトップメーカーであるコーヨン社が、より高度なユーザーニーズに迅速に応えるため、以下の内容を基本として相互協力し合う事で、技術開発を加速させます。

\* SPI機能：Solder Paste Inspection はんだ検査機能。はんだ検査は、はんだペースト印刷後の位置、形状を正確に測定することで、印刷品質の改善、実装品質の向上に役立つ。

#### (1) 「NXT II」のプラットフォームに対応するはんだ検査機能「IH3」の開発

コーヨン社の画像解析能力と光学技術に加え、当社の高速高精度位置決め技術や画像処理技術を組み合わせることで、これまでにない小型の3次元 SPI システムの開発に取り組みました。コーヨン社は「NXT II」への対応のため、光学系の再設計を行い、検査ヘッドの小型化に成功しました。4方向から干渉縞を投影することで、死角のない高精度な3次元測定を実現しています。今回開発した3次元はんだ検査ヘッド「IH3」は、処理装置「IH3 コントローラ」とともに、「NXT II」に搭載することで、NXT の特徴であるモジュール構造となり、検査機の導入やレイアウトの変更を容易かつ自在に実現できます。さらに、検査用のデータもマウンターと同様、総合生産プログラム作成ツール「Fuji Flexa」上で CAD データから生成でき、印刷機、検査機、接着剤塗布、マウンターの各工程のジョブ\*が一元管理できるため、技術要員の削減にも寄与します。

「IH3」は組み合わせる「NXT II」の仕様により、量産小型基板のダブルコンベア仕様から、大型基板用のシングルコンベア仕様まで選択可能となっており、あらゆる「NXT II」ラインに対応できます。また、0402 サイズ部品\*対応の高解像度タイプや 1005 サイズ部品\*までの一般向け解像度のタイプなどから選択可能となっています。

\* ジョブ：基板の生産を行うために必要な全ての情報を含んだデータ。

\* 0402 サイズ部品・1005 サイズ部品：素子サイズ 0.4mm×0.2mm・1.0mm×0.5mmの小型部品。

#### (2) 小型高精度はんだ検査装置「Fuji SPICA」の開発

さらに、コーヨン社では「IH3」で開発した小型検査ヘッドを使用したスタンドアロンタイプの SPI 装置「SPICA」を開発しました。当社はこれを受け、「Fuji Flexa」とのインターフェー

ス付きモデル「Fuji SPICA」を用意。従来機のユーザーを中心にターンキーソリューションを提供します。

「IH3」を搭載した NXT モジュールは、Fuji SPICA と共に、6 月 1 日から開催されるプロテック 2011 に出展いたします。両機とも 10 月より受注を開始する予定です。

以上